

基于 Hifmcv100 控制器的 Flash 移植指南 00B03 cogothy only for sheathen

文档版本

发布日期

版权所有 © 上海海思技术有限公司 2019。保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任 何形式传播。

商标声明

(上) AISILICON、海思和其他海思商标均为海思技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受海思公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产 品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,海思公司对本文档内容不 做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用 有约 中央 Chanting Industrial Technology Chanting Industrial Indus 指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

上海海思技术有限

地址: 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编: 518129

网址: http://www.hisilicon.com

客户服务邮箱: support@hisilicon.com



概述

产品版本

本文档主要介绍如何基于 HiFMCV100 驱动新增 Flash 器件及常见问题分析。			
	40·.,		
与本文档相对应的产品版本	iFMCV100 驱动新增 Flash 器件及常见问题分析。 如下。 P品版本 V100 V101 in S		
产品名称	产品版本		
Hi3519	V100 Indus		
Hi3519	ري د م		
Hi3516A	V2000		
Hi3516C	V300		
Hi3516E Hi3516E Hi3516E Hi3516E Hi3516E	V100		
Hi3516E	V200		
Hi3516E 14	V300		
Hi3518E	V300		
Hi3316D	V200		
Hi3559	V100		
Hi3556	V100		
Hi3536C	V100		
Hi3536D	V100		
Hi3531D	V100		
Hi3521D	V100		
Hi35520D	V400		
Hi3559A	V100		
Hi3559C	V100		



产品名称	产品版本
Hi3518E	V200/V201
Hi3516C	C200
Hi3521A	V100
Hi3531A	V100
Hi3519A	V100
Hi3556A	V100
Hi3516C	V500
Hi3516D	V300
Hi3516A	V300
Hi3559	V200 (S')
Hi3556	V200
本文档(本指南)主要适用	V300 V300 V200 V200 V200 Technology F以死工程师:

读者对象

符号约定

在本文的可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

符号	说明
▲ 危险	用于警示紧急的危险情形,若不避免,将会导致人员死亡 或严重的人身伤害。
△警告	用于警示潜在的危险情形,若不避免,可能会导致人员死 亡或严重的人身伤害。
△注意	用于警示潜在的危险情形,若不避免,可能会导致中度或 轻微的人身伤害。
注意	用于传递设备或环境安全警示信息,若不避免,可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 不带安全警示符号的"注意"不涉及人身伤害。



符号	说明		
□ 说明	用于突出重要/关键信息、最佳实践和小窍门等。		
	"说明"不是安全警示信息,不涉及人身、设备及环境伤害信息。		

修订记录

成布。 Sterthen Fushi Chanling Industrial Technology Co. Ltd. Congrity Only For Sterthen Fushi Chanling Industrial Technology Co. Ltd. 修订记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新 内容。

文档版本 00B03(2019-01-04)

第3次临时发布。

新增 1.2.1.5 小节

文档版本 00B02 (2018-05-15)

第2次临时发布。

新增 1.2.1.4 小节

1.2.2.2 涉及修改

文档版本 00B01 (2017-10-10)

第1次临时发布。



前	- 言	i
1 亲	新 Flash 器件移植	1
1.1	見後	.
1.2 S	SPI Nor Flash 器件的移植	1
1.2.1	l SPI-Nor U-boot 下的移植	15 o 15
1.2.2	2 SPI-Nor 内核下的移植	20 ⁰³⁷
1.3 S	1 SPI-Nor U-boot 下的移植	
1.3.1	1 相关驱动路径	19
1.3.2	2 如何新増一颗 SPI Nand Flash	
1.4	1 相关驱动路径	27
1.4.1	1 相关驱动路径	27
1.4.2	2 并口 Nand ID 表系统	27
1.4.3	3 如何新增一颗并口 Nand 器件	29
2 常	常见问题整理 SPI Nor Flash 3byte/4byte 启动和 SPON and Flash 1/4 线启动	32
2.1 S	SPI Nor Flash 3byte/4byte 启动和 SPGN and Flash 1/4 线启动	32
2.2 F	Hiburn 显示烧写成功,但串口没 外 印	33
2.3 4	4bit ECC、8bit ECC 和 8bit(kk ECC、16bit/1k ECC	34
	使用大容量 NAND 应该对意的地方	
	为什么在 NAND 上公-boot 保存环境变量后,系统无法启动	
	如何正确使用 mtd-utils 的 nandwrite 裸写工具	
2.7	有些 Flash 器件 ID 不变工艺更新导致参数变化对兼容性的影响	36



插图目录

图 1-1 非标驱动中 SPI Nor ID 注册信息详解	3
图 1-2 15 状态寄存器	9
图 1-3 Bank 地址寄存器	9
图 1-4 Macronix MX25U25635F 4 线使能函数实现	11
图 1-5 非标驱动中 SPI Nor ID 注册信息详解	12
图 1-4 Macronix MX25U25635F 4 线使能函数实现	14
图 1-7 标准驱动中 SPI Nor ID 注册信息示例	16
图 1-7 标准驱动中 SPI Nor ID 注册信息示例	18
图 1-9 非标驱动中 SPI Nand ID 注册信息示例	20
图 1-10 Dual I/O SPI Read 时序图	22
图 1-10 Dual I/O SPI Read 时序图	23
图 1-12 不带 QE bit 的 Feature 寄存器	25
图 1-13 带 QE bit 的 Feature 寄存器	
图 1-14 并口 Nand Flash ID 含义	
图 1-15 并口 Nand ID 沿册信息示例	29
图 2-1 8-WSON 表现	33
图 2-2 SPI Nor 3Byte/4Byte 问题数据对比图	
图 2-3 SPI Nor/SPI Nand 4 线问题数据对比图	34
图 2-4 坏块分布示意图	35
图 2-5 Nand Flash 块结构图	
图 2-6 MXIC MX25L6406E ID 注册表	37
图 2-7 MXIC MX25L6436F 注册表	37
图 2-8 MT250 系列和 N250 系列命今差异	38



表格目录

表 1-1 SPI Nor Flash 器件相关的主要目录结构	2
表 1-2 SPI 接口匹配查询表	4
表 1-3 相关功能函数与厂家对应表	
表 1-4 SPI 接口匹配查询表	
表 1-5 SPI DTR 接口匹配查询表	3.0 ⁶³
表 1-6 标准化 SPI Nor 器件相关的主要目录结构	15
表 1-7 SPI Nand 器件相关的主要路径	19
表 1-6 标准化 SPI Nor 器件相关的主要目录结构	21
表 1-9 AC CHARACTERISTICS 表	23
表 1-10 并口 Nand 驱动 ID 移植相关的目录结构	27
表 1-10 并口 Nand 驱动 ID 移植相关的目录结构 Lishi cogoby only For	



1 新 Flash 器件移植

1.1 导读

本文档基于 HiFMCV100(Hisilicon Flash Memory Controller 以下简称 FMC)控制器,提供 FLASH 器件的移植方法。FMC 集成 SPI Nor Flash、SPI Nand Flash、并口 Nand Flash 三个控制器,部分平台上裁剪成二合一的控制器,即包含 SPI Nor Flash 和 SPI Nand Flash 两个控制器。

- 当选用的 SPI Nor Flash 器件的型号与SPI Nor Flash 器件兼容性列表中型号不同时,需要在 SPI Nor Flash 驱动的 ID 列表中新增器件 ID 节点以及器件相关的功能函数,主要包括读写擦类型、时钟、ID 值、实现并指定器件相关的功能函数(4Byte 寻址,四线读写使能 复位函数等)。
- 当选用的 SPI Nand Flask 器件的型号与 SPI Nand Flash 器件兼容性列表中型号不同时,需要在 SPI Nand Plash 驱动的 ID 列表中新增 ID 节点以及器件相关的功能函数,主要包括读写类型、时钟大小,ID 值、实现并指定四线使能处理函数。
- 当选用的并口**X** and Flash 器件的型号与并口 Nand Flash 器件兼容性列表中型号不同时,第一步先匹配 Nand Flash 协议层提供的公共器件列表,若公共表匹配出的器件信息不满足器件的实际情况,需要在并口 Nand Flash 驱动的特殊器件列表中新增器件 ID 节点。

1.2 SPI Nor Flash 器件的移植

由于 Flash 驱动都在标准化,内核下的 SPI Nor Flash 驱动已经匹配最新的标准化驱动框架,而 u-boot 下的 SPI Nor Flash 驱动使用的是非标准化的版本。

当前有 u-boot-2010.06 和 u-boot-2016.11 两个版本,两者的差异主要是 u-boot-2016.11 新增支持使用 **4 Byte 命令**访问大于 16MB 的 SPI Nor Flash,详见 1.2.1.4 u-boot-2016.11 下大于 16MB SPI Nor Flash 的移植小节。

1.2.1 SPI-Nor U-boot 下的移植

1.2.1.1 相关驱动路径

目前 u-boot 下的 SPI Nor Flash 驱动使用的是没有标准化的版本。



u-boot 下的路径: drivers/mtd/spi/hifmc100/

非标准化 SPI NorFlash 驱动新器件移植有关系的目录如下表 1-1 所示。

表1-1 SPI Nor Flash 器件相关的主要目录结构

Hifmc100 目录/文件名	描述
hifmc_spi_nor_ids.c	SPI Nor Flash 器件 ID 表,移植新的器件主要修改的文件,主要包含 SPI Nor Flash 器件的读写擦的参数和功能函数钩子的赋值。
hifmc100_spi_general.c	SPI Nor Flash 驱动大部分器件通用的功能函数代码。 包含写使能等操作,4Byte 寻址与四线读写,但是只 适应部分厂商,特殊器件需要根据器件手册增加相应 的实现函数
hifmc100_spi_gd25qxxx.c hifmc100_spi_micron.c hifmc100_spi_mx25125635e.c hifmc100_spi_s25f1256s.c hifmc100_spi_w25q256fv.c	部分特殊器件中的功能函数与 hifmc100_spi_general.c 中的驱动不匹配,只能额外增加这些器件具体功能的驱动实现,主要是 4bxte 寻址(32M 或以上容量器件),QUAD 四线读写,QE 位使能函数。

1.2.1.2 如何新增一颗 SPI Nor Flash

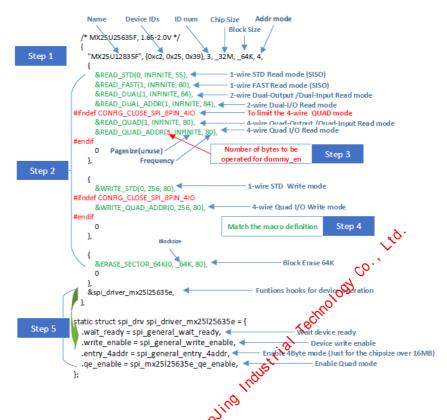
新移植一个 SPI Nor Flash 器件,简单来说就是往 hifmc_spi_nor_ids.c 的 ID 注册信息结构体中增加一个 ID 节点,如图 1-1 所示。

接下来我们以 Macronix MX25U25635F 为例,详细讲述如何在 ID 表里面新增一颗 SPI Nor Flash。

-dobuy Only Fr



图1-1 非标驱动中 SPI Nor ID 注册信息详解



步骤 1 查阅 MX25U25635F 的器件手册。新增 ID 节点,在节点的相应位置填 ID 信息。

找到9Fh命令下的ID信息。

从图中可以看出该器体育3个ID,分别是: 0xC2、0x20、0x19。

Table 6. ID Definitions

Command Type		MX25L25635F			
RØ1D	9Fh	Manufactory ID	Memory type	Memory density	
Spin C	9FN	C2	20	19	
_ CQ2	•				

获取器件的 chip size、block size 信息

- 256Mb: 268,435,456 x 1 bit structure or 134,217,728 x 2 bits (two I/O mode) structure or 67,108,864 x 4 bits (four I/O mode) structure
- Equal Sectors with 4K byte each, or Equal Blocks with 32K byte each or Equal Blocks with 64K byte each

步骤 2 从器件手册的 Features 章节中获取器件所支持的接口类型。



- · Fast read for SPI mode
 - Support clock frequency up to 133MHz for all protocols
 - Support Fast Read, 2READ, DREAD, 4READ, QREAD instructions.
 - Configurable dummy cycle number for fast read operation
- · Quad Peripheral Interface (QPI) available
- Equal Sectors with 4K byte each, or Equal Blocks with 32K byte each or Equal Blocks with 64K byte each

- Any Block can be erased individually

通过查询表 1-2,可以匹配出 MX25U25635F 支持的接口及其对应的驱动中的宏定义,如表 1-2 底色是灰色的行所示。

此外,Erase 操作我们默认匹配 Block Erase 64K 命令。

表1-2 SPI 接口匹配查询表

器件支持的接口	命令字	对应的 FMC 的接口	驱动中的宏定义
READ	03h	Standard SPI (%)	READ_STD
FAST READ	0Bh	Standard SPI	READ_FAST
2READ	3Bh	Dual-Output Dual-Input SPI	READ_DUAL
DREAD	BBh	Duall O SPI	READ_DUAL_ADDR
4READ	6Bh	Quad-Output/Quad- Input SPI	READ_QUAD
QREAD	EBh Chanling	Quad I/O SPI	READ_QUAD_ADD R
PP	02h	Standard SPI	WRITE_STD
DPP(page program)	02h	Dual-Output/Dual-Input SPI	WRITE_DUAL
2PP ONLY OPPOSIT	D2h	Dual I/O SPI	WRITE_DUAL_ADD R
QPB9	32h	Quad-Output/Quad- Input SPI	WRITE_QUAD
4PP	38h	Quad I/O SPI	WRITE_QUAD_ADD R
Block Erase 4K	02h	Standard SPI	ERASE_SECTOR_4K
Block Erase 32K	52h	Standard SPI	ERASE_SECTOR_32 K
Block Erase 64K	D8h	Standard SPI	ERASE_SECTOR_64 K
Block Erase 128K	D8h	Standard SPI	ERASE_SECTOR_12 8K
Block Erase	D8h	Standard SPI	ERASE_SECTOR_25



器件支持的接口	命令字	对应的 FMC 的接口	驱动中的宏定义
256K			6K

步骤 3 确定接口的 dummy 值和工作时钟。

Dummy num 的确认

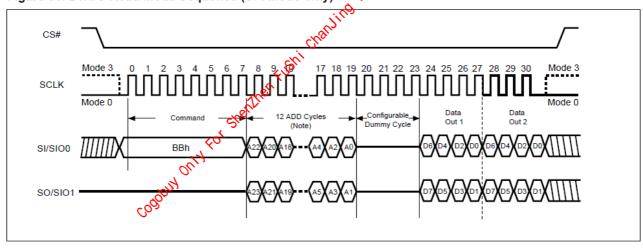
根据 SPI Nor Flash 的 SPI 接口的定义的特点,可以有以下结论。

- Standard SPI STD Read 和所有 Write 及 Erase 接口的 Dummy 值为 0;
- Dual-Output/Dual-Input SPI 和 Quad-Output/Quad-Input SPI 接口 Dummy 值为 1;
- Dual I/O SPI 和 Quad I/O SPI 的接口 Dummy 值需要参考手册计算:

◎━━ 窍门

a) Dual I/O SPI Read

Figure 30. 2 x I/O Read Mode Sequence (SPI Mode only)



从器件手册中的波形图可以看出 Dual I/O SPI Read 需要 20-23 的 4 个 dummy cycle 的时钟周期,又因为接口是两线,所以相当于要有 8 dummy cycle bit,相当于 1 dummy cycle Byte。根据芯片手册 dummy_num 的定义: &READ_DUAL_ADDR(1, INFINITE, 84)中 dummy 值填 1。

b) Quad I/O SPI Read

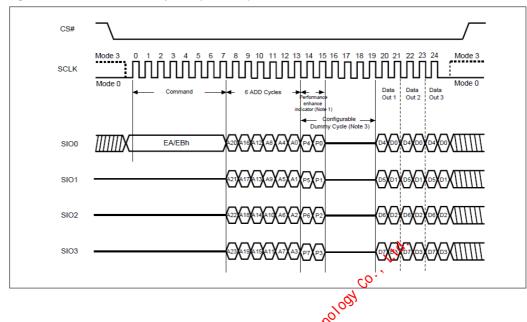


Figure 32. 4 x I/O Read Mode Sequence (SPI Mode)

从器件手册中的波形图可以看出 Quad I/O SRE Read 需要 14-15 的 2 个 cycle 的 Performance enhance(有的厂家的器件是 N7-M0)的时钟周期,16-19 的 4 个 dummy cycle 的时钟周期,加起来 6 个 cycle。又因为接口是四线,所以相当于要有 24 dummy cycle bit,相当于 3 dummy cycle Byte。根据芯片手册 dummy_num 的 定义: &READ_QUAD_ADDR (30INFINITE, 80)中 dummy 值填 3。

● 接口工作时钟

接口&READ_QUAD_ABDR(3, INFINITE, 80)中的工作频率是依据每个手册里面的AC CHARACTERISTICS 表获取。

Table 16. AC CHARACTERISTICS (Temperature = -40°C to 85°C, VCC = 2.7V ~ 3.6V)

Symbol	Alt.	Parameter (S)	Min.	Тур.	Max.	Unit
fSCLK	fC	Clock Frequency (Pall commands (except Read)	D.C.		133	MHz
fRSCLK	fR	Clock Frequency for READ instructions			50	MHz
fTSCLK	fT	Clock Frequency for 2READ instructions			84 ⁽⁷⁾	MHz
fQ fQ		Clock Frequency for 4READ instructions			84 ⁽⁷⁾	MHz
•		COR				

注意

从手册里面可以看到器件所能支持的最高接口时钟 84MHz/133MHz, 跟以上举例的 MX25U25635F ID 节点的时钟信息有出入, 这是因为目前 FMC 对于 1.8V IO 接口时钟最高只能支持 150MHz(也就是 75MHz), 所以这里填个 80MHz, 一方面是为了限制接口时钟, 一方面是为了匹配步骤 4 中的宏定义。

步骤 4 当根据上面几个步骤填好如下图接口的信息之后,要匹配宏定义。



```
&READ_STD(0, INFINITE, 55),

&READ_FAST(1, INFINITE, 80),

&READ_DUAL(1, INFINITE, 84),

&READ_DUAL_ADDR(1, INFINITE, 84),
#ifndef CONFIG CLOSE SPI 8PIN 4IO

&READ_QUAD(1, INFINITE, 80),

&READ_QUAD_ADDR(3, INFINITE, 80),
#endif
&WRITE_STD(0, 256, 80),
#ifndef CONFIG CLOSE SPI 8PIN 4IO
                        &WRITE QUAD ADDR(0, 256, 80),
#endif
```

```
在 hifmc_spi_nor_ids.c 源代码路径开头几行中匹配宏定义。

SET_READ_STD(0, INFINITE, 66);
SET_READ_FAST(1, INFINITE, 80)
SET_READ_DUAL(1, INFINITE, 80)
SET_READ_DUAL_ADDR(1, INFINITE, 85);
SET_READ_QUAD(1, INFINITE, 80);
SET_READ_QUAD(1, INFINITE, 00);
SET_READ_QUAD_ADDR(3, INFINITE, 80);
SET_WRITE_STD(0, 256, 80);
SET_WRITE_QUAD(0, 256, 80);
       ERASE SECTOR 64K(0, 64K, 80);
```

步骤 5 匹配完接口信息,最好一步要匹配器件相关功能函数钩子&spi_driver_mx25125635e (结构体 struct spi_arv),我们需要关注的以下几个接口赋值:

```
.wait_ready = spi_general_wait ready,
 .write_enable = spi_general_write_enable,
 .exry 4addr = spi general entry 4addr,
qe_enable = spi_mx25125635e_qe_enable,
```

目前驱动中对于大部分 SPI Nor Flash 厂家的所使用的功能函数都是有匹配的,如果新 增器件是表格中所列厂家的器件可以尝试使用现成的,不需要额外匹配。

表1-3 相关功能函数与厂家对应表

厂家	struct spi_drv 赋值	源文件	
GigaDevice (GD)	&spi_driver_gd25qxxx	hifmc100_spi_gd25qxxx.c	
Micron	&spi_driver_micron	hifmc100_spi_micron.c	
MXIC (Macronix)	&spi_driver_mx25125635e	hifmc100_spi_mx25125635e.c	
Spansion	&spi_driver_s25fl256s	hifmc100_spi_s25fl256s.c	



厂家	struct spi_drv 赋值	源文件
Winbond	&spi_driver_w25q256fv	hifmc100_spi_w25q256fv.c
其他通用适配	&spi_driver_general	hifmc100_spi_general.c

• .wait_ready = spi_general_wait_ready, 等待器件 ready。

通过读器件状态寄存器的 WIP bit 来判断器件是否处于空闲状态,一般所有 SPI Nor Flash 的满足这个机制。

WIP bit. The Write in Progress (WIP) bit, a volatile bit, indicates whether the device is busy in program/erase/write status register progress. When WIP bit sets to 1, which means the device is busy in program/erase/write status register progress. When WIP bit sets to 0, which means the device is not in progress of program/erase/write status register cycle.

• .write_enable = spi_general_write_enable,写使能接口。。

通过写器件状态寄存器的 WEL bit 来改变器件是否可操作,一般所有 SPI Nor Flash 的满足这个机制。

WEL bit. The Write Enable Latch (WEL) bit, a volatile bit, indicates whether the device is set to internal write enable latch. When WEL bit sets to 1, which means the internal write enable latch is set, the device can accept program/erase/write status register instruction. When WEL bit sets to 0, which means no internal write enable latch; the device will not accept program/erase/write status register instruction. The program/erase command will be ignored if it is applied to a protected memory area. To ensure both WIP bit & WEL bit are both set to 0 and available for next program/erase/operations, WIP bit needs to be confirm to be 0 before polling WEL bit. After WIP bit confirmed, WEL bit needs to be confirm to be 0.

□ 说明

因为各个厂家对器件状态寄存器的命名方法有差异,但是访问寄存器的命令字是一样的,所以下面我们使用命令家果区分 SPI Nor Flash 的状态寄存器: 05 状态寄存器、35 状态寄存器和 15 状态寄存器。

如上所诉 WIP bit 和 WEL bit 基本上在所有的 SPI Nor Flash 的 05 状态寄存器上的位置都一致,都是第%和第 1 个 bit 位置;

Status Register

Status Regist							
bit7	bit6 o	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
SRWD (status register write protect)		BP3 (level of protected block)	BP2 (level of protected block)	BP1 (level of protected block)	BP0 (level of protected block)	WEL (write enable latch)	WIP (write in progress bit)
1=status register write disable	1=Quad Enable 0=not Quad Enable	(note 1)	(note 1)	(note 1)	(note 1)	1=write enable 0=not write enable	1=write operation 0=not in write operation
Non-volatile bit	Non-volatile bit	Non-volatile bit	Non-volatile bit	Non-volatile bit	Non-volatile bit	volatile bit	volatile bit

但下面的 3Byte/4Byte 切换和 QE 使能所涉及的 35 状态寄存器和 15 状态寄存器不同厂家和器件存在很大的差异,所以下面将以一个专题来讲解。

---结束



1.2.1.3 3Byte/4Byte 切换和 QE 使能专题

.entry_4addr = spi_general_entry_4addr 和 qe_enable = spi_mx25l25635e_qe_enable, 这两个接口内容比较多,作为一个专题来讲解。

□ 说明

用户在移植新的 Flash 器件时,需要根据器件的具体情况来适配 3Byte/4Byte 模式切换的接口。

- .entry_4addr = spi_general_entry_4addr, 切换器件 3Byte/4Byte 模式的接口, 这个接口只有的那个器件容量大于 16MB 才会调用。
 - 一般的器件 SPI Nor Flash 都是提供 Enter 4-byte mode (EN4B)和 Exit 4-byte mode (EX4B)来实现器件 3Byte/4Byte 模式的切换,并通过判断 15 状态寄存器的 bit5 来判断是否切换成功。

图1-2 15 状态寄存器

Configuration Register

bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 GH2 bit1 bit0 DC1 DC0 TΒ DDS 2 ODS 1 ODS 0 4 BYTE (Dummy (Dummy Reserved (top/bottom output driver (output driver (output driver cycle 1 cycle 0) selected strength) strength) strength) 0=3-byte address 0=Top area mode protect 1=Bottom (note 2) (note 2) 1=4-byte (note 1) (note 1) (note 1) address area protect mode (Default=0) (Default=0) volatile bit volatile bit volatile bit OTP volatile bit volatile bit volatile bit

而其他器件在切换 3Byte/4Byte 模式之间的差异总体上分为以下三类:

- 切换 3Byte/4Byte 模式的方式不一样:

典型的就是 Spansion(现在的 Cypress)的.entry_4addr = spi_s25f256s_entry_4addr,不是通过发 EN4B 和 EX4B 命令来切换 3Byte/4Byte 模式的,而是通过改变 Bank Address Register 的 bit7 的值来切换。

图1-308ank 地址寄存器

Table 8.16 Bank Address Register (BAR)

Bits	Fleid Name	Function	Туре	Default State	Description
7	EXTADD	Extended Address Enable	Volatile	0b	1 = 4-byte (32-bits) addressing required from command. 0 = 3-byte (24-bits) addressing from command + Bank Address
6 to 1	RFU	Reserved	Volatile	00000b	Reserved for Future Use
0	BA24	Bank Address	Volatile	0	A24 for 256-Mbit device, RFU for lower density device

- 通过命令来切换 3Byte/4Byte 模式,但是检查是否切换成功的寄存器不是 15 状态寄存器,典型的就是 Micron 的 SPI Nor Flash 的.entry_4addr = spi_micron_entry_4addr 接口是通过检查器件的 FLAG STATUS REGISTER 的bit0 来判断切换 3Byte/4Byte 模式是否成功。



- 不能简单通过 EX4B 命令来将 4Byte 模式切换回 3Byte 模式,得通过发复位命 令来切换,典型的就是 Winbond 的 W25Q256 系列器件

.entry_4addr = spi_w25q256fv_entry_4addr,的接口得用直接发复位组合命令 的方式来将 4Byte 模式切换回 3Byte 模式。

.qe_enable = spi_mx25l25635e_qe_enable,器件四线使能的函数接口。

注意

驱动中是通过 CONFIG CLOSE SPI 8PIN 4IO 宏来打开和关闭四线接口, BVT 的很多 平台上是默认不开放四线接口的,这是因为对于8PIN 封装的器件IO 3和 RESET 引 脚是复用在一起的,我们一般默认复用为 RESET 功能。

使能器件的 QE (QUAD ENABLE) bit 的差异主要是不同厂家不同器件的 QE bit 分布不一样导致的。这些不一样只能通过实际的器件手册来分析。

样细讲的 Father Figure Cooper Out For sheather Figure Cooper Out Figure Figure Cooper Out Figure Fig 接下来我们以 Macronix MX25U25635F 为例详细讲解 一下这个接口的函数实现,

文档版本 00B03 (2019-01-04)

版权所有 © 上海海思技术有限公司



图1-4 Macronix MX25U25635F4 线使能函数实现

```
static int spi_mx25l25635e_qe_enable(struct hifmc_spi *spi)
 unsigned char status, op;
 unsigned int regval;
 const char *str[] = {"Disable", "Enable"};
 struct hifmc host *host = (struct hifmc host *)spi->host;
 op = spi is quad(spi); <----

    Judge weather 4-wire mode should be supported

 status = spi_general_get_flash_register(spi, SPI_CMD_RDSR);
 if (MX_SPI_NOR_GET_QE_BY_SR(status) == op) {);
 Get the status register to check the value of QE bit
 spi->driver->write_enable(spi);
 if (op)
   status |= MX SPI NOR SR QE MASK; -
   status &= ~MX_SPI_NOR_SR_QE_MASK; <
                                                 Turn off OF
 writeb(status, host->iobase);
                                Tag 2
 regval = FMC_CMD_CMD1(SPI_CMD_WRSR);
 hifmc_write(host, FMC_CMD, regval);
                                                       The flow owriting back to
 regval = OP_CFG_FM_CS(spi->chipselect);
 hifmc write(host, FMC OP CFG, regval);
                                                       status exister above.
 regval = FMC_DATA_NUM_CNT(SPI_NOR_SR_LEN);
                                                       Note there is one-to-one
 hifmc write(host, FMC DATA NUM, regval);
                                                       correspondence command
 regval = FMC OP CMD1 EN(ENABLE)
                                                       Between read and write
    | FMC_OP_WRITE_DATA_EN(ENABLE)
                                                       status register, please check
    FMC_OP_REG_OP_START;
                                                       from datasheet
 hifmc write(host, FMC OP, regval);
 FMC_CMD_WAIT_CPU_FINISH(host);
  spi->driver->wait_ready(spi);
                                                               Check whether the
 status = spi_general_get_flash_register(spi_&P_CMD_RDSR);
                                                               set successfully
 if (MX_SPI_NOR_GET_QE_BY_SR(status) \(\overline{\text{Op}}\))
                                              Tag 3
   FMC_PR(QE_DBG, "\t| |-%s Quad suscess, status:%#x.\n", str[op],
       status);
  else
   DB_MSG("Error: %s Quad feeed! reg: %#x\n", str[op], status);
  return op:
     如果需要新增一个 QE 使能接口,可以参考上面的代码实现,代码流程不需要更
          需要关注的是代码中的几处标识:
        tag1: 读 OE bit 所在器件寄存器的命令;
        tag2: 写 QE bit 所在器件寄存器的命令;
    - tag3: 判断 QE bit 是否设置成功。
```

1.2.1.4 u-boot-2016.11 下大于 16MB SPI Nor Flash 的移植

目前使用 u-boot-2016.11 版本的芯片平台优化了 HiFMCV100 控制器,解除需要硬件接reset 管脚的限制。但对于容量大于 16MB 的器件必须要求支持 4 Byte 命令。目前,驱动中只适配了 Winbond、Macronix(MXIC)和 Micron 三个厂家,用户若想适配其他厂家的支持 4Byte 命令的器件,在 drivers/mtd/spi/hifmc100/hifmc_spi_nor_ids.c 路径下,找到下面代码段,增加相应的 case 代码分支。



注意

如果移植的大于 16MB 的 SPI Nor Flash 器件不支持 4Byte 命令〉 请参考 1.2.1.2 "如何新增一颗 SPI Nor Flash"进行移植,但是必须把接口限制成2线且硬件连 reset 引脚。

如图 1-5,接下来我们还是以 **Macronix MX25U256357** 为例,详细讲述如何在 ID 表里面新增一颗支持 4Byte 命令的 SPI Nor Flash。

图1-5 非标驱动中 SPI Nor ID 注册信息详解

```
Name IDs ID num Ship Size Block Size Addr Mode
           /* MX25U25635F, 1.65\2.0V */
             "MX25U256355", {0xc2, 0x25, 0x39}, 3, _32M, _64K, 4,
Step 1
               &READ STD4B(0, INFINITE, 55), 1-wire STD Read 4Byte Mode(SISO) &READ_FAST4B(1, INFINITE, 108), 1-wire Fast Read 4Byte Mode(SISO)

    2-wire Dual-I/O Read 4Byte Mode

               &READ_QUAD4B(1, INFINITE, 108),

    4-wire Quad-Output/Quad-Input Read 4Byte Mode

               &READ_QUAD_ADDR4B(3, INFINITE, 108),

    4-wire Quad-I/O Read 4Byte Mode

               0
                                                               Number of bytes to be
                                                                                        Step 3
ξο<sup>00</sup> 2
                            Pagesize(unuse) Frequency
                                                              operated for dummy_en
               &WRITE STD4B(0, 256, 80),

    1-wire STD Write 4Byte Mode

               &WRITE_QUAD_ADDR4B(0, 256, 108), ◀—
                                                        - 4-wire Quad-I/O Write 4Byte Mode
               0
                                                            Match the macro definition
                                                                                        Step 4
               &ERASE_SECTOR_64K4B(0, _64K, 108), ◆ Block Erase 64KB
               0
             &spi_driver_mx25l25635e,
         static struct spi_drv spi_driver_mx25l25635e = {
                                                          Wait device ready
           .wait_ready = spi_general_wait_ready,
                                                            Device Write Enable
                                                                                  Step 5
           .write_enable = spi_general_write_enable,
                                                            Enable Quad Mode
           .entry_4addr = spi_general_entry_4addr,
           .qe_enable = spi_mx25l25635e_qe_enable,
                                                            Enable 4 Byte mode
```



从器件手册的 command set 章节中确认是否支持 4Byte 命令。

Table 6. Read/Write Array Commands (4 Byte Address Command Set)

Command (byte)	READ4B	FAST READ4B	2READ4B	DREAD4B	4READ4B	QREAD4B	4DTRD4B (Quad I/O DT Read)
Mode	SPI	SPI	SPI	SPI	SPI/QPI	SPI	SPI/QPI
Address Bytes	4	4	4	4	4	4	4

通过查询表 1-4,可以匹配出 MX25U25635F 支持的接口及其对应的驱动中的宏定义,如表 1-4 底色是灰色的行所示。

此外, Erase 操作我们默认匹配 Block Erase 64K4B 命令。

表1-4 SPI 接口匹配查询表

			<u> </u>
器件支持的接口	命令字	对应的 FMC 的接口	驱动中的宏定义
READ4B	13h	Standard SPI	READ_STD4B
FAST READ4B	0Ch	Standard SPI molosi	READ_FAST4B
2READ4B	3Ch	Dual-Output/Dual-Input SPI	READ_DUAL4B
DREAD4B	BCh	DualI/O SPI	READ_DUAL_ADDR4B
4READ4B	6Ch	Quad Output/Quad-Input	READ_QUAD4B
QREAD4B	EBh Shi	Quad I/O SPI	READ_QUAD_ADDR4B
PP4B	1211	Standard SPI	WRITE_STD4B
4PP4B	3 Eh	Quad I/O SPI	WRITE_QUAD_ADDR4B
BE4K4B Blocks Erase 4K4B	21h	Standard SPI	ERASE_SECTOR_4K4B
BE32K4B Block Erase 2K	5Ch	Standard SPI	ERASE_SECTOR_324B K
BE4B Block Erase 64K	DCh	Standard SPI	ERASE_SECTOR_64K4B

1.2.1.5 DTR 模式 SPI Nor Flash 的移植

对于支持 Double Transfer Rate(DTR)模式的 Flash 器件,以 **Macronix MX25L25645G** 为例,讲述如何适配一颗支持 DTR 模式的 SPI Nor Flash。

注意

Flash 器件本身支持 DTR 功能,才能进行 DTR 模式的适配。DTR 模式只支持读操作。



驱动中通过宏开关 CONFIG_DTR_MODE_SUPPORT 来打开和关闭 DTR 接口,BVT 的 很多平台上是默认没有打开 DTR 接口的,使用 DTR 模式必须确保四线接口开放。

- u-boot-2010.06 版本支持 DTR 模式的宏开关在文件 include/configs/hi35xx.h 中。
- u-boot-2016.11 版本支持 DTR 模式的宏开关在 menuconfig 中通过选项 Device Drivers-> SPI Flash Support-> Hisilicon Spi Nor Device DTR mode Support 打开。

同 STR 单沿模式适配的不同点,如图 1-6 所示的红色标记部分。

图1-6 注册信息示例图

```
"MX25L(256/257)XX",
             {0xc2, 0x20, 0x19}, 3, _32M, _64K, 4,
                    &READ_STD(0, INFINITE, 40/*50*/),
&READ_FAST(1, INFINITE, 104),
                                                   ndustrial rectinology co., Ltd.
                    &READ_DUAL(2, INFINITE, 104)
&READ_DUAL_ADDR(1, INFINITE, 84), #ifndef CONFIG_CLOSE_SPI_8PIN_4IO
                    &READ_QUAD_ADDR(3, INFINITE, 75),
#endif
#ifdef CONFIG_DTR_MODE_SUPPORT
                    &READ_QUAD_DTR(10, INFINITE, 84)
#endif
             },
                    &WRITE STD(0, 256, 75),
#ifndef CONFIG_CLOSE_SPI_8PIN_4IO
                    &WRITE_QUAD_ADDR(0, 256, 104),
#endif
             },
                    &ERASE_SECTOR_64K(0, 264K, 80)
             %spi_driver_mx25l2563
```

DTR 模式移植步骤跟 1.2.1.2 "如何新增一颗 SPI Nor Flash"章节一样,这里不再赘述。下面主要阐述同 1.2.1.2 章节步骤 2 的差异。

从厂家提供的器件手册"Features"章节中获取器件所支持的接口类型。

- Fast read for SPI mode
 - -Support clock frequency up to 133MHz for all protocols
 - Support Fast Read, 2READ, DREAD, 4READ, QREAD instructions
 - Support DTR (Double Transfer Rate) Mode
 - Configurable dummy cycle number for fast read operation

通过表 1-5 所示,可以匹配出 MX25U25645G DTR 的接口及其对应的驱动中的宏定义。

表1-5 SPI DTR 接口匹配查询表

器件支持的接口	命令字	对应的 FMC 的接口	驱动中的宏定义		
4DTRD4B	EEh	DTR Fast Read Quad I/O	READ_QUAD_DTR		
4DTRD	EDh	DTR Fast Read Quad I/O	READ_QUAD_DTR_WINB		



器件支持的接口	命令字	对应的 FMC 的接口	驱动中的宏定义
			OND

1.2.2 SPI-Nor 内核下的移植

1.2.2.1 相关驱动路径

目前内核下的 SPI Nor 驱动使用的是标准化的版本。

驱动路径: drivers/mtd/spi-nor/

标准化 SPI Nor 驱动新器件移植有关系的目录如表 1-6 所示。

表1-6 标准化 SPI Nor 器件相关的主要目录结构

Hifmc100 目录/文件名	描述。
spi-nor.c	标准驱动框架,定义 SPLWor 驱动中主要的数据结构;定义 SPI Nor 器件 id 表。移植新 SPI Nor 器件主要修改的文件;区分不同器件。3/4byte 切换及其四线使能等操作。

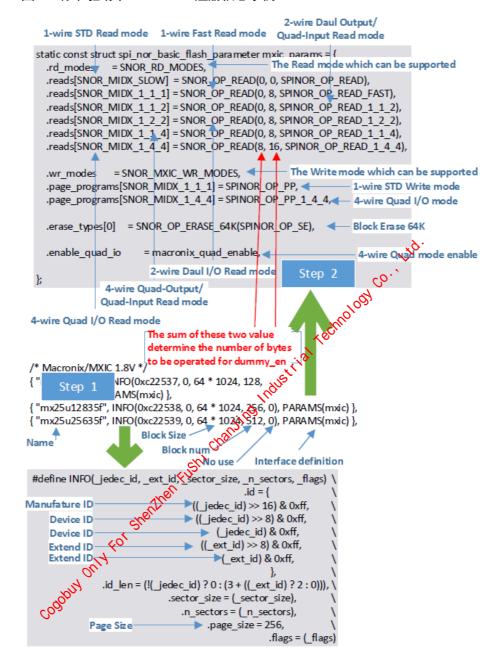
1.2.2.2 如何新增一颗 SPI Nor Flash

描一颗 SPI Nor Flash
新移植一个 SPI Nor Flash 器件,C简单来说就是往 spi-nor.c 的 ID 注册信息结构体中增加 一个ID节点,如图1-7所承

接下来我们以 Macronix MX25U25635F 为例,详细讲述如何在 ID 表里面新增一颗 SPI Nor Flash.



图1-7 标准驱动中 SPI Nor ID 注册信息示例



注意

不像 SPI Nor 的非标准化驱动,可以对同一个厂家的不同器件适配不同的接口函数,标准驱动中,只对厂家做出区分,如果同一个厂家不同的器件在接口类型的匹配上存在差异,可能需要限制接口来兼容。

步骤 1 查阅 MX25U25635F 的器件手册,新增 ID 节点,在节点的相应位置填信息; 找到 9Fh 命令下的 ID 信息:



Table 6. ID Definitions

Command Type		MX25L25635F			
BDID	OEh	Manufactory ID	Memory type	Memory density	
KUID	RDID 9Fh		20	19	

从图中可以看出该器件有3个ID,分别是: 0x2C、0x20、0x19。

获取器件的 chip size、block size 信息,分别是 32MB、64KB:

- 256Mb: 268,435,456 x 1 bit structure or 134,217,728 x 2 bits (two I/O mode) structure or 67,108,864 x 4 bits (four I/O mode) structure
- · Equal Sectors with 4K byte each, or Equal Blocks with 32K byte each or Equal Blocks with 64K byte each

步骤 2 由于 FMC 已经下表大部分厂家的 SPI Nor Flash 的接口类型、dummy 值、3Byte/4Byte 切换和 QE 使能做出限定。当新增器件是下表所列出的器件时,请直接使用厂家对于的 PARAMS 宏定义。

	<i>M</i> ,
厂家	宏定义
ESMT	PARAMS(estat)
GigaDevice	PARAMS(gd)
Macronix/MXIC	PARAMS(mxic)
Micron	PARAMS(micron)
Spansion (Light)	PARAMS(spansion)
Winbond	PARAMS(winbond)
Paragon	PARAMS(paragon)

步骤 3 确定的工作时钟。

注意

版本默认发布地工作时钟的值是经过兼容性测试的,所以这个值不建议修改。

参考器件手册中 AC CHARACTERISTICS 表获取器件的工作时钟,根据实际使用的接口类型选择相应的时钟:

Table 16. AC CHARACTERISTICS (Temperature = -40°C to 85°C, VCC = 2.7V ~ 3.6V)

Symbol	Alt.	Parameter		Тур.	Max.	Unit
fSCLK	fC	Clock Frequency for all commands (except Read)	D.C.		133	MHz
fRSCLK	fR	Clock Frequency for READ instructions			50	MHz
ELCCI K	fT	Clock Frequency for 2READ instructions			84 ⁽⁷⁾	MHz
fTSCLK	fQ	Clock Frequency for 4READ instructions			84 ⁽⁷⁾	MHz



□ 说明

由于目前兼容性列表里面的所有器件都支持 FAST READ(由 DTS 中的 m25p,fast-read 指定),所以上图中 READ 命令(对应 STD READ)支持的最大时钟 50MHz 可以忽略。从器件手册上,我们可以看到,器件所能支持的最大时钟频率是 133MHz,但是 2READ/4READ 接口只能支持到 84MHz,由于对于该器件我们是全接口支持(通过 PARAMS(mxic)定义的都是全接口支持),所以我们设置器件的时钟频率应该取较小的 84MHz 时钟,如下图(路径:drivers/mtd/spinor/spi-nor.c):

```
{ "mx25u25635f", INFO(0xc22539, 0, 64 * 1024, 512,
SPI_NOR_QUAD_READ | SPI_NOR_4B_OPCODES), PARAMS(mxic), CLK_MHZ_2X(84) },
```

□ 说明

如图 1-8, PARAMS(mxic)全接口支持表示的是 MXIC 的器件支持 1-wire(STD 和 FAST READ)、2-wire(DUAL-OUTPUT/DUAL-INPUT 和 DUAL-I/O)、4 wire(QUAD-OUTPUT/QUAD-INPUT 和 QUAD-I/O)所有接口。当 ID 节点中 PARAMS(mxic)参数缺省时,器件的接口类型由节点里面的 SPI_NOR_QUAD_READ/SPI_NOR_QUAL_READ 指定。所以,当新增器件无法全接口匹配时,可以使用 SPI_NOR_QUAD_READ/SPI_NOR_DUAL_READ 指定器件的接口。

图1-8 PARAMS(mxic)释义

```
static const struct spi_nor_basic_flash_parameter mxic_params = {
            = SNOR_RD_MODES,
  .reads[SNOR_MIDX_SLOW] = SNOR_OP_READ(0, 0, SPINOR_OP_READ),
  reads[SNOR_MIDX_1_1_1] = SNOR_OP_READ(0, 8, SPINOR_OP_READ_FAST), ← 1-wire Fast Read Mode(SISO)
reads[SNOR_MIDX_1_1_2] = SNOR_OP_READ(0, 8, SPINOR_OP_READ_1_1_2), ← 2-wire Dual-Output/Dual-Input Read Mode
  reads[SNOR_MIDX_1_2_2] = SNOR_OP_READ(0, 8, SPINOR_OP_READ_1_2_2), ← 2-wire Dual-I/O Read Mode
  reads[SNOR_MIDX_1_4_4] = SNOR_OP_READ(8, 16, STNOR_OP_READ_1_4_4), ← 4-wire Quad-I/O Read Mode
             = SNOR_MXIC_WR_MODES,
  .page_programs[SNOR_MIDX_1_1_1] = SPINOR P_PP.

    1-wire STD Write Mode

  - 4-wire Quad-I/O Write Mode
  .erase_types[0]
               = SNOR_OP_ERASE_64K(SPINOR_OP_SE),

    Block Erase 64KB

  .enable_quad_io
                                                           Enable Quad Mode
};
```

确定完器件所能支持的最大时钟,接下来就要确定芯片 CRG 提供给 FMC 控制器的最大时钟,参考对应芯片的芯片手册的系统章节,假如 FMC 的时钟源最佳可以匹配到 150MHz 的时钟,在 arch/arm/boot/dts/hi35xx-demb.dts 文件中,找到以下设备节点:

```
&hisfc {
    hi_sfc {
        compatible = "jedec,spi-nor";
        reg = <0>;
        spi-max-frequency = <150000000>;
        m25p,fast-read;
    };
};
```



并更改 spi-max-frequency = <150000000>;的值,**注意:** 真实填写到这个节点的频率值都 是 2X 时钟, 也就是说当 spi-max-frequency 参数填写 150000000 (Hz) 时, CRG 实际 提供的时钟是75MHz。

综合上面提到的器件时钟和 CRG 时钟,这两个的最小值就是实际接口时钟 75MHz。

---结束

1.3 SPI Nand Flash 器件的移植

1.3.1 相关驱动路径

目前 SPI Nand 驱动使用的都是没有标准化的版本。

SPI Nand 驱动的路径: drivers/mtd/nand/hifmc100/

非标准化 SPI Nand 驱动新器件移植有关系的目录如下的

表1-7 SPI Nand 器件相关的主要路径

Hifmc100目录/文件名	描述
hifmc_spi_nand_ids.c	SPI Name 器件 ID 表,移植新 SPI Nand 器件主要修改的文件。主要包含 SPI Nand 器件的读写擦除参数;
hifmc100_spi_general.c	SPI Nand 驱动大部分器件通用的功能驱动代码,包含写使能操作、QE bit 使能函数。

1.3.2 如何新增 -颗 SIYNand Flash

FMC 控制器自身集成 ECC 纠错功能, FMC 启动之后会关掉 SPI Nand Flash 器件的 ECC, 而关闭 ECC 这个动作, 只能支持将 B0h Feature 寄存器的 bit4 置成 0。所以, 判 断一颗 SPI Nand Flash 器件 FMC 能不能支持的第一步就是先看看这颗器件的 BOh Feature 寄存器的 bit4 是否是 ECC EN bit, 如果不是, 那就不支持。

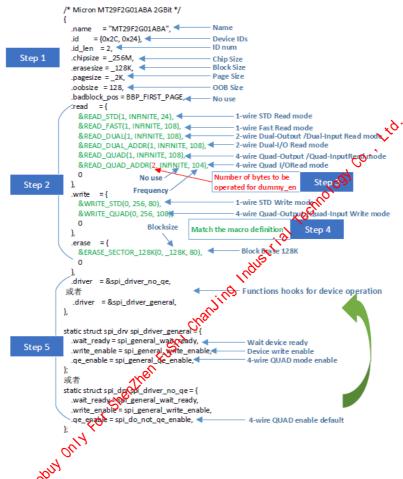
Di-t	A -l -l	Data Bits								
Register	Address	7	6	5	4	3	2	1	0	
Block Lock	АОН	BRWD	Reserved	BP2	BP1	BP0	INV	СМР	Reserved	
ОТР	вон	OTP_PRT	OTP_EN	Reserved	ECC_EN	Reserved	Reserved	Reserved	QE	
Status	СОН	Reserved	Reserved	ECCS1	ECCS0	P_FAIL	E_FAIL	WEL	OIP	



新移植一个 SPI Nand Flash 器件,简单来说就是往 $hifmc_spi_nand_ids.c$ 的 ID 注册信息 结构体中增加一个 ID 节点,如图 1-9 所示。

接下来我们以 Micron MT29F2G01ABA 为例,详细讲述如何在 ID 表里面新增一颗 SPI Nand Flash:

图1-9 非标驱动中 SPI Nand ID 注册信息示例



步骤 1 查阅 T29F2G01ABA 的器件手册,新增 ID 节点,在节点的相应位置填信息

找到 9Fh 命令下的 ID 信息:

Table 3: READ ID Table

Byte	Description	7	6	5	4	3	2	1	0	Value
Byte 0	Manufacturer ID (Micron)	0	0	1	0	1	1	0	0	2Ch
Byte 1	2Gb 3.3V Device ID	0	0	1	0	0	1	0	0	24h

从 ID 表里可以看出, MT29F2G01ABA 有 2 个 ID: 0x2C、0x24。

获取器件的 **chip size、block size、page size、OOB size** 信息,其他信息不确定的情况下,请保持跟示例中的 ID 信息一致:



- 2Gb density
- Organization
 - Page size x1: 2176 bytes (2048 + 128 bytes)
 - Block size: 64 pages (128K + 8K bytes)
 - Plane size: 2Gb (2 planes, 1024 blocks per plane)

步骤 2 从手册的 Features 章节中获取器件所支持的接口类型:

- Standard and extended SPI-compatible serial bus interface
 - Instruction, address on 1 pin; data out on 1, 2, or 4 pins
 - Instruction on 1 pin; address, data out on 2 or 4

pins

- Instruction, address on 1 pin; data in on 1 or 4 pins

通过查询表 1-8,可以匹配出 MT29F2G01ABA 支持的接口及其对应的驱动中的宏定 义,如下表底色是灰色的行所示。根据步骤 1 中我们可以知道 MT29F2G01ABA 的 block size 是 128K,所以我们应该匹配 Block Erase 128K 命令。

表1-8 SPI 接口匹配查询表

器件支持的接口	命令字	对应的 FMC 的接口	驱动中的宏定义
READ	03h Shi	Standard SPI	READ_STD
FAST READ	OBA	Standard SPI	READ_FAST
2READ	3Bh	Dual-Output/Dual-Input SPI	READ_DUAL
DREAD 60	BBh	DualI/O SPI	READ_DUAL_ADDR
4READ ONL'	6Bh	Quad-Output/Quad-Input SPI	READ_QUAD
QREAD	EBh	Quad I/O SPI	READ_QUAD_ADDR
PP	02h	Standard SPI	WRITE_STD
DPP	A2h	Dual-Output/Dual-Input SPI	WRITE_DUAL
2PP	D2h	Dual I/O SPI	WRITE_DUAL_ADDR
QPP	32h	Quad-Output/Quad-Input SPI	WRITE_QUAD
4PP	38h	Quad I/O SPI	WRITE_QUAD_ADDR
Block Erase 4K	02h	Standard SPI	ERASE_SECTOR_4K
Block Erase 32K	52h	Standard SPI	ERASE_SECTOR_32K
Block Erase 64K	D8h	Standard SPI	ERASE_SECTOR_64K



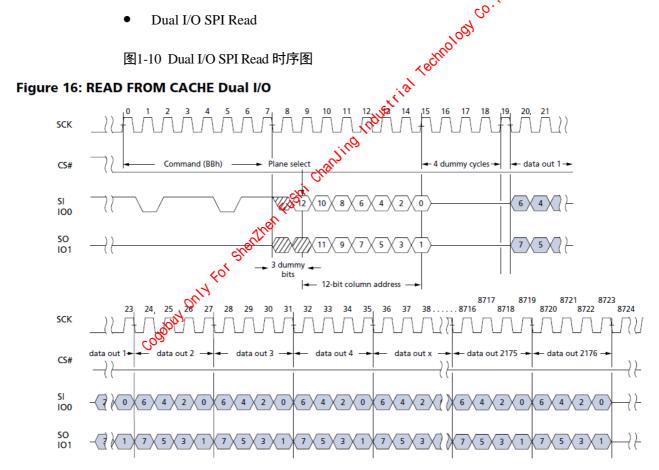
器件支持的接口	命令字	对应的 FMC 的接口	驱动中的宏定义
Block Erase 128K	D8h	Standard SPI	ERASE_SECTOR_128K
Block Erase 256K	D8h	Standard SPI	ERASE_SECTOR_256K

步骤 3 确定接口的 dummy 值和工作时钟:

1. Dummy num 的确认

参照手册 SPI Nand Flash 的 SPI 接口的定义:

- (1) Standard SPI STD Read 和所有 Write 及 Erase 接口的 Dummy 值为 0;
- (2) Dual-Output/Dual-Input SPI 和 Quad-Output/Quad-Input SPI 接口 Dummy 值为 1;
- (3) Dual I/O SPI 和 Quad I/O SPI 的接口 Dummy 值要参考手册计算:



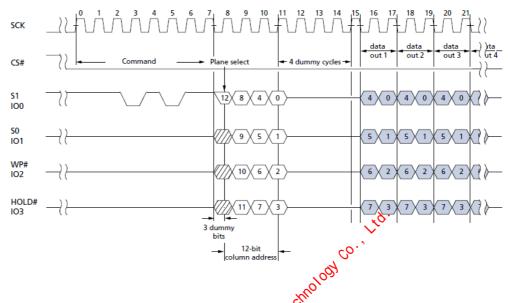
从器件手册中的波形图可以看出 Dual I/O SPI Read 需要 15-18 的 4 个 dummy cycle 的时钟周期,又因为接口是两线,所以相当于要有 8 dummy cycle bit,相当于 1 dummy cycle Byte。根据芯片手册 dummy_num 的定义: &READ_DUAL_ADDR(1, INFINITE, 108)中 dummy 值填 1。

• Ouad I/O SPI Read



图1-11 Ouad I/O SPI Read 时序图

Figure 17: READ FROM CACHE Quad I/O



从器件手册中的波形图可以看出 Quad I/O SPER ead 需要 11-14 的 4 个 dummy cycle 的时钟周期。又因为接口是四线,所以根置于要有 16 dummy cycle bit,相当于 2 dummy cycle Byte。根据芯片手册 dummy_num 的定义: &READ_QUAD_ADDR (2, INFINITE, 108)中 dummy 值填 2。

2. 接口工作时钟

举个例子,接口&READ_QUAD_ADDR(2, INFINITE, 108),中的工作频率是依据每个手册里面的 AC CHARACTERISTICS 表获取。

表1-9 AC CHARACTERISTICS 表

Table 17: AC Characteristics

Parameter , 4	Symbol	Min	Max	Unit
Clock frequence	fC	-	133	MHz
Clock LOW The	tWL	3.375	_	ns
Clock HIGH time	tWH	3.375	-	ns
Clowrise time	^t CRT	1.3	-	V/ns
Clock fall time	^t CFT	1.3		V/ns
Command deselect time	tCS	30	-	ns
Chip select# active setup/hold time relative to SCK	tCSS/tCSH	3.375	-	ns
Chip select# non-active setup/hold time relative to SCK	^t CSH	2.5	-	ns
Output disable time	^t DIS	-	6	ns
Data input setup time	tSUDAT	2.5	-	ns
Data input hold time	tHDDAT	1.75	-	ns
Clock LOW to output valid (30pF)	tV.	-	6	ns
Clock LOW to output valid (10pF)	tV.	-	5	ns
Clock LOW to output valid (similar to SPI NOR 20 MHz read 30pF)	^t ∨	-	30	ns

Notes: 1. Read from Cache Dual I/O (BBh) and Quad I/O (EBh) can run up to 108 MHz.

步骤 4 当根据上面几个步骤填好如下图接口的信息之后,要匹配宏定义。

When read protocol similar to SPI NOR is enabled, Read from Cache 03h command can run up to 20 MHz, while read from Cache 0Bh command can run up to 133 MHz.



```
&READ_STD(1, INFINITE, 24),
&READ_FAST(1, INFINITE, 108),
&READ_DUAL(1, INFINITE, 108),
     &READ_DUAL_ADDR(1, INFINITE, 108)
     &READ_QUAD(1, INFINITE, 108),
     &READ_QUAD_ADDR(2, INFINITE, 104),
.write
              = {
     &WRITE_STD(0, 256, 80),
&WRITE_QUAD(0, 256, 108),
.erase
     &ERASE SECTOR 128K(0, 128K, 80),
```

```
SET_READ_FAST(1, INFINITE, 108);
SET_READ_DUAL(1, INFINITE, 104);
SET READ DUAL ADDR (1, INFINITE, 108);
    READ QUAD (1, INFINITE, 108)
    READ_QUAD_ADDR(2, INFINITE, 104);
WRITE_STD(0, 256, 80);
WRITE_QUAD(0, 256, 108)
    ERASE SECTOR 128K(0 128K, 80)
```

步骤 5 匹配完接口信息,最后一步要匹配器件相关函数钩子&spi_driver_no_qe, (结构体 struct spi_drv),我们需要关注的以下几个:

```
.wait_ready = spi_general_wait_ready,
.write enable = spi general write enable,
.qe_enab🅸
          = spi_general_qe_enable,或.qe_enable = spi_do_not_qe_enable,
```

自前驱动中对于大部分 SPI Nand Flash 厂家的所使用的功能函数都是有匹配的,如果新增器件是 表格中所列厂家的器件可以尝试使用现成的, 不需要额外匹配:

厂家	struct spi_drv 赋值
GigaDevice	&spi_driver_general
Micron	&spi_driver_no_qe
MXIC	&spi_driver_general
Winbond	&spi_driver_general
ESMT	&spi_driver_no_qe
ATO	&spi_driver_general
Paragon	&spi_driver_general



厂家	struct spi_drv 赋值
All-flash	&spi_driver_general
TOSHIBA	&spi_driver_no_qe
HeYangTek	&spi_driver_general

.wait_ready = spi_general_wait_ready,等待器件 ready。
 通过读器件 C0h feature 寄存器的 bit0 WIP 来判断器件是否处于空闲状态,目前所有 SPI Nand Flash 的满足这个机制。

WIP bit. The Write in Progress (WIP) bit, a volatile bit, indicates whether the device is busy in program/erase/write status register progress. When WIP bit sets to 1, which means the device is busy in program/erase/write status register progress. When WIP bit sets to 0, which means the device is not in progress of program/erase/write status register cycle.

.write_enable = spi_general_write_enable,写使能接及
 通过写 C0h feature 寄存器的 bit1 WEL 来改变器件是否可操作,目前所有所有 SPI Nand Flash 的满足这个机制。

WEL bit. The Write Enable Latch (WEL) bit, a volatile bit discretes whether the device is set to internal write enable latch. When WEL bit sets to 1, which means the internal write enable latch is set, the device can accept program/erase/write status register instruction. When WEL bit sets to 0, which means no internal write enable latch; the device will not accept program/erase/write status register instruction. The program/erase command will be ignored if it is applied to a protected memory area. To ensure both WIP bit & WEL bit are both set to 0 and available for next program/erase/operations, WIP bit needs to be confirm to be 0 before polling WEL bit. After WIP bit confirmed, WEL bit needs to be confirm to be 0.

□ 说明

区别于 SPI Nor Elosh, SPI Nand Flash 器件是不需要复位脚的, 因为 FMC 会自动下发复位命令, 所以, SPI Nand Flash 默认匹配为四线模式。但是, 不是所有的厂家的 SPI Nand Flash 器件出厂时都默认四线, 根据 QE bit 的情况分为两类:

图1-12、不带 QE bit 的 Feature 寄存器

Table 5: Feature Address Settings and Data Bits

	Feature		Feature Data Bits							
Register	Address	7	6	5	4	3	2	1	0	Notes
Block lock	Address = A0h; Access = R/W	BRWD	BP3	BP2	BP1	BP0	TB	WP#/HOLD# Disable	_	1, 2
Configuration	Address = B0h; Access = R/W	CFG2	CFG1	LOT_EN	ECC_EN	-	-	CFG0	-	1
Status	Address = C0h; Access = R	CRBSY	ECCS2	ECCS1	ECCS0	P_Fail	E_Fail	WEL	OIP	1



图1-13 带 QE bit 的 Feature 寄存器

Feature Register Table

Do eleken	A d d	Data Bits							
Register	Address	7	6	5	4	3	2	1	0
Block Lock	АОН	BRWD	Reserved	BP2	BP1	BP0	INV	CMP	Reserved
ОТР	вон	OTP_PRT	OTP_EN	Reserved	ECC_EN	Reserved	Reserved	Reserved	QE
Status	СОН	Reserved	Reserved	ECCS1	ECCS0	P_FAIL	E_FAIL	WEL	OIP

 .qe_enable = spi_do_not_qe_enable,器件四线接口使能的函数接口: Micron MT29F2G01ABA 器件默认上电是四线使能,所以不需要使能四线。
 但是,有的 SPI Nand Flash 需要使能四线才能使用 QUAD 接口,对应的函数接口是: .qe_enable = spi_general_qe_enable。

```
static int spi_general_qe_enable(struct hifmc_spi *spi)
  unsigned int reg, op;
  const char *str[] = {"Disable", "Enable"};
                               Judge weather 4-wire mode
  op = spi is quad(spi);
                                   should be supported
  reg = spi_nand_feature_op(spi, GETCOP, FEATURE_ADDR, 0);
  if ((reg & FEATURE_QLENABLE) op) {
    FMC_PR(QE_DBG, "\t\\*-$P\Nand quad was %sd!\n", str[op]);
  Get the status register to check the value of QE bit
  if (op == ENABLE)
    reg |= FEATURE QE ENABLE; -
    reg &=KFEATURE_QE_ENABLE; ◀
  spi_and_feature_op(spi, SET_OP, FEATURE_ADDR, reg);
          Write back to feature register
                                                       Check whether the
  spi->driver->wait ready(spi);
                                                        set successfully
  reg = spi nand feature op(spi, GET OP, FEATURE ADDR, 0);
  if ((reg & FEATURE_QE_ENABLE) == op)
    FMC_PR(QE_DBG, "\t|||-SPI Nand %s Quad succeed!\n", str[op]);
  else
    DB_MSG("Error: %s Quad failed! reg: %#x\n", str[op], reg);
  FMC_PR(QE_DBG, "\t||*-End SPI Nand %s Quad.\n", str[op]);
  return op;
```



□ 说明

当前市面上的 SPI Nand Flash 的 QE bit 使能都是遵循上面驱动中的操作。如果所新增的器件 QE bit 使能的方式有所差异,可以参考上面的驱动代码进行修改。

步骤 6 将 ID 合入到 hifmc_spi_nand_ids.c 文件中后,编译烧写上电启动查看 U-boot 的打印信 息,查看 ECC 是否跟手册要求的 ECC 类型匹配:

- User-selectable internal ECC supported
 - 8 bits/sector

驱动匹配出的 ECC 大小必须保证不小于 SPI Nand Flash 手册要求的 ECC 大小。建议用 户在实际使用过程中尽量匹配更高的 ECC 类型,这样有利于提高器件的寿命。

rote trial Technology CO. 在使用量产工具(spinand_product/nand_product)制作烧录镜像时,所输入ECC type 参数:

ECC type ECC size:

- 4bit/512B
- 2 16bit/1K
- 3 24bit/1K
- 4 28bit/1K

一定要匹配实际使用的 ECC type, 或以从 u-boot 驱动打印信息中获取。

---结束

1.4 并口 Nand 驱动

1.4.1 相关驱动路径

- 并以Nand 驱动使用是非标准化版本。
- プロ Nand 驱动的路径: drivers/mtd/nand/hifmc100_nand/
- 并口 Nand 驱动新器件移植有关系的目录,如表 1-10 所示。

表1-10 并口 Nand 驱动 ID 移植相关的目录结构

Hifmc100 目录/文件名	描述
hifmc_nand_spl_ids.c	并口 Nand 特殊器件 ID 表,移植新并口 Nand 器件主要修改的文件。

1.4.2 并口 Nand ID 表系统



注意

FMC 控制器集成 ECC 纠错功能,不需要并口 Nand 器件自身进行 ECC 纠错。目前发现,有的厂家出厂的并口 Nand 器件自身携带 ECC 纠错功能,且还是无法关闭的,对于这种器件 FMC 不建议支持,一则需要下发特殊的命令字去读取 ECC 纠错的 bit 数,会增加驱动的复杂度,不利于维护;再则,实际使用过程中,发现经过两次 ECC (器件自身 ECC+FMC ECC)之后会存在一些很难解释的出错现象。所以,对于这类并口 Nand 器件,不建议支持。

并口 Nand 驱动中包括了两个表:

- 公共 ID 表: 内核 nand 适配层通过识别并解析 ID 信息,获取器件的 chip size、block size、page size、OOB size 信息。
- 特殊 ID 表: 但是不是所有的并口 Nand 通过 nand 适配层识别出来的信息都能满足器件的实际需求,所以又定义了一套特别器件 ID 表。

公共 ID 表

读取的并口 Nand 的 ID 中,是读取好几个字节,或我最少是 4 个,新的芯片,支持 5 个甚至更多,从这些字节中,可以解析出很多相关的信息,比如此 Nand Flash 内部是几个芯片(chip)所组成的,每个 chip 包含了几片(Plane),每一片中的页大小,块大小,等等。如图 1-14 所示,在并口 Nandon ID 信息中,可以识别出此 flash 是 SLC 还是 MLC,以及 chip size、block size、page size、OOB size 信息。

图1-14 并口 Nand Flash ID 含义 💍

Device Identifier Byte	Description
1st	Mana Recturer Code
2nd	Device Identifier
3rd col	Internal chip number, cell type, etc.
4th	Page Size, Block Size, Spare Size, Serial Access Time, Organization
5th (S34ML02G1, S34ML04G1)	ECC, Multiplane information



特殊 ID 表

图1-15 并口 Nand ID 注册信息示例

```
{ /* SLC S34ML02G200TFI000 */
  .name = "S34ML02G200TFI000", <
                                                             – Device IDs
       = {0x01, 0xDA, 0x90, 0x95, 0x46, 0x00, 0x00, 0x00},
  .length = 5, ←
                                  - ID num
  .chipsize = 256M,
  .probe = NULL, <
                                   No use
  .pagesize = 2K, <
                                   Page Size
                                   Block Size
  .erasesize = 128K,
                                   OOB Size
  .oobsize = 128, <
  .options = 0, \blacktriangleleft
                                                               Read retry Flag( No use)
  .read_retry_type = NAND_RR_NONE,
  .badblock_pos = BBP_FIRST_PAGE,
                                                               No use
                                                               NAND SANDOMIZER etc. Flags
  .flags = 0,
},
```

1.4.3 如何新增一颗并口 Nand 器件

步骤 1 首先,尝试一下匹配公共 ID 表。参考器件手册 Feature 章节,检查 u-boot(或者 kernel)下打印出的器件信息是否满足器件 册中的要求,如果满足那么就不需要额外增加 ID 信息来支持该器件。

<u>FEATURES</u>

Organization

 $\begin{array}{ll} \text{Memory cell array} & 2176 \times 64 \text{K} \times 8 \\ \text{Register} & 2176 \times 8 \\ \text{Page size} & 2176 \text{ bytes} \\ \text{BlockSize} & (128 \text{K} + 8 \text{K}) \text{ bytes} \end{array}$

△警告

- 驱动匹配出的 ECC 大小必须保证大于或等于 Nand Flash 手册要求的 ECC 大小。
- 在使用量产工具(nand_product)制作烧录镜像时,所输入ECC type 参数:

ECC type ECC size:

- 1 4bit/512B 2 16bit/1K 3 24bit/1K 4 28bit/1K 5 40bit/1K 6 64bit/1K
- 一定要匹配实际使用的 ECC type, 可以从 u-boot 驱动打印信息中获取。



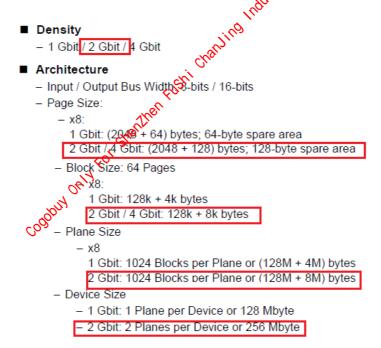
- 步骤 2 如果通过步骤一匹配公共 ID 表的方式, 匹配到的器件信息不满足器件手册的要求, 那 么就必须在特殊 ID 表中增加相应的 ID 信息。
- 步骤 3 接下来我们以 **Spansion S34ML02G200TFI000** 为例,详细讲述如何在 ID 表里面新增 并口 Nand Flash:
- 步骤 4 详细阅读前两个小节的内容,找到相应的 ID 表的路径,并了解 ID 表信息的含义;
- 步骤 5 查阅 S34ML02G200TFI000 器件手册,找到 90h 命令下的 ID 信息:

Density	Org	V _{CC}	1st	2nd	3rd	4th	5th
1 Gb	x8	- 3.3V	01h	F1h	80h	1Dh	_
2 Gb			01h	DAh	90h	95h	46h
4 Gb			01h	DCh	90h	95h	56h
1 Gb	x16		01h	C1h	80h	5DJb).	_
2 Gb			01h	CAh	90h	D5h	46h
4 Gb			01h	CCh	90h	c9 D5h	56h

Table 3.3 Read ID for Supported Configurations

可以看出 **S34ML02G200TFI000** 有 5 个 ID: 0x01、0xDA、0x90、0x95、0x46。

步骤 6 从手册的 Features 章节中获取器件信息,新增 ID 节点,在节点的相应位置填信息。



根据上述信息填写相应的 ID 表,如下:



```
/* SLC S34ML02G200TFI000 */
            = "S34ML02G200TFI000"
  .name
            = \{0x01, 0xDA, 0x90, 0x95, 0x46, 0x00, 0x00, 0x00\},
  .id
            = 5,
= _256M,
  .length
  .chipsize
            = NULL,
  .probe
              _2K,
  .pagesize
  .erasesize =
               128K,
            = \overline{128},
  .oobsize
  .options
   .read_retry_type = NAND_RR_NONE,
  .badblock_pos
                 = BBP FIRST PAGE,
   .flags = \overline{0},
```

步骤7 将 ID 合入到 hifmc_nand_spl_ids.c 文件中后,编译烧写上电启动查看 U-BOOT 的打印 信息,查看 ECC 是否跟手册要求的 ECC 类型匹配(必须大于于册要求的 ECC 类 型)。

■ Reliability

ischology - 100,000 Program / Erase cycles (Typ) (with 4-bit ECC per 528 bytes (x8) or 264 words (x16))

注意

对于 Spansion S34ML02G200TF1000, 虽然通过匹配公共 ID 表也能满足手册中 ECC 类 型的要求,但是由于 FMC 🏖 OOBSIZE 为 128Byte 情况下,可以匹配到更高的 24bit/1K。这边我们会建议用户在实际使用过程中尽量匹配更高的 ECC 类型,这样有 利于提高器件的寿命

---结束



2 常见问题整理

2.1 SPI Nor Flash 3byte/4byte 启动和 SPI Nand Flash 1/4 线启动

3Byte/4Byte 地址位宽这个概念是针对于 SPI Nor 的。它片在上电启动的时候,会去读取 SPI Nor Flash 的前 1MB 空间,单板上的 3Byte Byte 决定了控制器读取时下发的地址宽度。

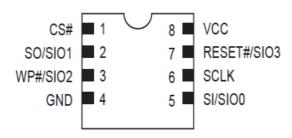
- 3Byte 地址位宽最大的寻址空间是 16MB,所以对于容量不大于 16MB 的 SPI Nor Flash 的 3Byte/4Byte 模式拨码必须是 3Byte;
- 对于大部分 32MB 及其更大容量的 SPI Nor Flash, 出厂时器件默认是 3Byte 模式, 意味着只能访问前 16MB 空间, 所以此时 3Byte/4Byte 模式拨码必须是 3Byte;
- 对于一小部分 32MB 发其更大容量的 SPI Nor Flash,比如 MXIC MX25L25735E 和 Winbond W25Q257FV,出厂时器件默认是 4Byte 模式,这类器件 3Byte/4Byte 模式拨码必须是 4Byte。

1/4 线启动是铁网 SPI Nand Flash 的,这里必须强调 SPI Nor Flash 是默认 1 线启动,几乎所有的 SPI Nand Flash 都支持 1 线和 4 线,4 线接口向下兼容 1 线。1/4 线拨码取决于硬件设计:

- c 图 2-1 SIO3 接到芯片上有效 IO 上时,表示支持 4 线,1/4 线拨码应拨成 4 线启动,可以得到更快的启动速度;
- 当图 2-1 SIO3 没有接有效 IO 时,这种场景是有的,因为 BVT 的产品 SPI Nor 和 SPI Nand 是共焊盘的,而 SPI Nor Flash IO3 一般复用成 reset 信号,此时 1/4 线拨码应拨成 1 线启动。



图2-1 8-WSON 封装



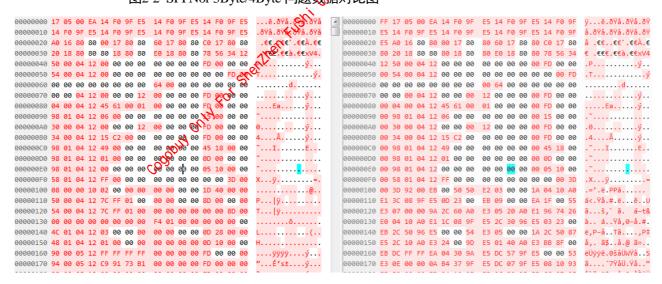
2.2 Hiburn 显示烧写成功,但串口没打印

实际使用过程中,我们都会出现这样一个场景,我们可能会遇到这样的一个场景,命名 Hiburn 提示写成功,但是串口却狂打空格。一般情况下有两个情况可能导致这种问题:

• SPI Nor 3Byte/4Byte 问题

确认 3Byte/4Byte 问题的方法是,Fastboot 先选择烧写 DDR,启动之后读写数据,如果发现读出来的数据跟原始数据对比发现数据发现错位,基本上可以确认是 3Byte/4Byte 接口问题。还有一种厂家是掉电能启动,发复位命令发现 Flash 启动不了,一般也是这个问题。

图2-2 SPI Nor 3Byte/4Byte 问题数据对比图



SPI Nor 3Byte/4Byte 问题处理方法: 检查一下单板拨码,或者要检查一下软件复位流程是否成功。

SPI Nor/SPI Nand 4 线问题

确认 4 线接口问题的方法是,Fastboot 先选择烧写 DDR, 启动之后读写数据, 如果发现读出来的数据跟原始数据对比出现很多这种 1bit 翻转的情况, 基本上可以确认是 4 线接口问题。



图2-3 SPI Nor/SPI Nand 4 线问题数据对比图



SPI Nor/SPI Nand 4 线问题处理方法:检查一下硬件的接口连线。

- IO3 比较接有效的 IO 信息线;
- IO3 必须加上拉。

2.3 4bit ECC、8bit ECC和 8bit/1k ECC、16bit/1k ECC

由于历史原因,用户可能会对 4bit ECC 和 8bit/1K ECC, 8bit ECC 和 16bit/1k ECC 产生混淆。器件说的 4bit ECC 和 8bit ECC 每个纠错单元是 512B,而 HiFMCv100 的 8bit 和 16bit 每个纠错单元是 1KB(1KB 指 1KB 数量级,并不是严格意义上的 1024Byte; 512B 指 512 数量级,并不是严格的 512Byte,一般是 526Byte)。所以,其实 4bit/512B 等价于 8bit/1K,8bit/512B 等价于 16bit/1K。

建议我们的开发和支撑人员在跟客户交流 ECC 的时候,把纠错单元的大小也指明,免得造成误解。

2.4 使用大容量 NAND 应该注意的地方

大容量 NAND 是指容量>4G 的 NAND 器件。4G 是一个 32 位无符号整型所能表示的最大极限,超过这个界限,32 位变量会发生回绕。当前测试过的最大容量为8G。使用>4G 的器件时,应该注意文件系统(UBI/YAFFS2)分区大小不能超过4G,否则文件系统可能回绕。

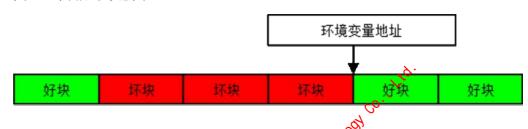


2.5 为什么在 NAND 上, u-boot 保存环境变量后,系统无法启动.

有些用户在 NAND 上烧写完 u-boot 后,系统能正常启动,但保存环境变量后,系统无 法启动。

原因如图 2-4 所示, u-boot 占三个好块, NAND 起始位置有三个坏块, 保存环境变量后, fastboot 内容被擦除, 系统无法启动。这个时候, 要把环境变量地址往后挪。

图2-4 坏块分布示意图



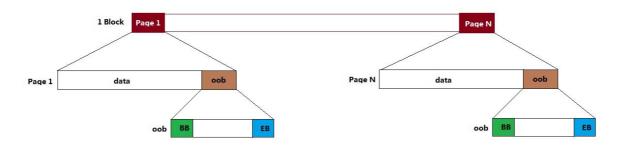
2.6 如何正确使用 mtd-utils 的 nandwrite 裸写工具

使用 mtd-utils 的 nandwrite 裸写工具时,如果写的是 u-boot.bin 镜像,且镜像大小大于 Nand Flash 的一个块的大小,一定要保证 u-boot.bin 镜像的数据按块对齐填充。否则,写进去的 u-boot.bin 镜像无法正常启动。

具体原因如下:

由于个别 Nand Flash 出厂时本块标记位(BB,Bad Block)被标记为非全 0 的数,例如 0xFE,在判断坏块的时候,容易被 FMC 控制器利用 ECC 纠错为 0xFF(因为全 0xFF 在 控制器的 ECC 算法上设合法可纠错的),故在每一个 page 的 OOB 信息的最后两个 byte 设置空块标记(EBS Empty Block)位。如图 2-5 所示,在 u-boot 启动时,逻辑上把 block 视为好块的前提条件是: block 的第一个 page 1 和最后一个 page N 的 BB=0xFF,EB=0x00。

图2-5 Nand Flasy 块结构图



nandwrite 是根据镜像文件大小逐页写数据的,并且写 page 时,会自动将当页的 EB 位配置为 0x00。当写的最后一个 page 不是所在 block 的最后一个 page 时,由于所在



block 最后一个 page 的 EB=0xFF,逻辑就是视这个 block 为空块不会去读数据,导致 uboot 启动失败。

值得注意的是,由于 Nand Flash 器件出厂时保证第一个块为好块,故逻辑不会去判断第一个块的情况,所以当 u-boot.bin 镜像大小小于一个块大小时,uboot 是可以正常启动的。

此外,一旦 uboot 正常启动,软件上我们不会再去判断 EB 位,这也是为什么使用 nandwrite 写内核镜像和文件系统镜像时可以不考虑镜像大小是否块对齐。

2.7 有些 Flash 器件 ID 不变工艺更新导致参数变化对兼容性的影响

伴随着 Flash(SPI Nor/SPI Nand/并口 Nand)工艺的不断更新, Flash 器件的接口、OOB 和性能等参数在不断的改变和优化。

某些厂家为了图方便,虽然 Flash 制作工艺升级了,但是 Flash ID 没有变化。而驱动是通过 ID 去识别器件的,不会通过厂家建议的 SFDP 资存器去识别器件的批次、工艺等信息,因为 SFDP 不是标准的,各个厂家存在差异,即使同一个厂家,新老器件也会有差异。

因此,底下列出的 Flash 器件都是 ID 一致多参数不一致导致影响兼容性的几种情况。假如客户用到以下的(或者有相同情况》器件,可以参考下面的例子进行修改驱动,从而保证器件有正常的功能和优越的性能。

• SPI Nor Flash 的 ID 不变,美口类型变化

MXIC MX25L6436F 跟MXIC MX25L6406E 比较,ID 一致,但是 MX25L6436F 接口类型增加了 2x I/② Read Mode/4x I/O Read Mode/4x I/O Page Program 的支持。

对于 MXIC MX25L6406E,hifmc_spi_nor_ids.c(hifmcv100)或 hisfc350_spi_ids.c (hisfc350)文件中的器件信息结构体 hifmc_spi_nor_info_table(hifmcv100)或 spi_info_table (hisfc350) 应该定义为:

, kudopo



图2-6 MXIC MX25L6406E ID 注册表

对于 MXIC MX25L6436F,hifmc_spi_nor_ids.c(hifmcv100)或 hisfc350_spi_ids.c(hisfc350)文件中的器件信息结构体 hifmc_spi_nor_info_table(hifmcv100)或 spi_info_table(hisfc350)应该定义为:

图2-7 MXIC MX25L6436F 注册表

● SPI Nor Flash 的 ID 不变,命令字变化 Micron SPI Nor 器件 MT25Q 系列和 N25Q 系列 EXTENDED QUAD INPUT FAST PROGRAM 命令不一样,如图 2-8 所示。



图2-8 MT25Q 系列和 N25Q 系列命令差异

15. The code 38h is valid only for part numbers N25Q256A83ESF40x, N25Q256A83E1240x, and N25Q256A83ESFA0F; the code 12h is valid for the other part numbers.

对于 Micron 的器件,如果用更高性能的 WRITE_QUAD_ADDR 接口类型,对于 MT25Q 系列,可以直接通过配置 WRITE_QUAD_ADDR 使用,因为现在驱动默 认是匹配 38h 的命令。

Congress on y For sheathen fushi chanting Industrial Technology Co., Lind.